

## Duitse start-up introduceert 3D-fabricage voor elektronica

Tot nu toe waren op maat gemaakte behuizingen van elektronische componenten alleen weggelegd voor de 'grote jongens'. De productie van behuizingen op maat is alleen mogelijk met een hoge output en vergt hoge omschakelkosten. Hierdoor moeten klanten die geïnteresseerd zijn in prototyping en kleine tot middelgrote series zich beperken tot standaardversies, en blijft maatwerk onbetaalbaar.

De onlangs ontwikkelde KONEKT-technologie biedt een oplossing waarmee zelfs kleine aantallen op een kostenefficiënte manier kunnen worden geproduceerd. Binnenkort kunnen middelgrote en kleine bedrijven toegang krijgen tot producten zoals flexibel aanpasbare en krachtige sensoren en connected



apparaten. KONEKT maakt gebruik van slimme productie voor het fabriceren van behuizingen voor componenten, zodat de behuizing kan worden geproduceerd in aantallen die variëren van prototypen tot middelgrote series (schaalbaar tot grote aantallen).

De productie van hele System-in-Packages is ook mogelijk omdat KONEKT ook een compleet nieuwe toolkit voor elektrotechnici en ontwerpers biedt.

Een hogere mate van ontwerpvrijheid kan worden bereikt door gebruik te maken van 3D-behuizingen, waardoor vergaande miniaturisatie mogelijk is.

Materialen kunnen ook worden aangepast, resulterend in specifieke eigenschappen om bestendigheid tegen onder andere hitte, fysieke belasting en explosie te garanderen.

Hoogfrequente verbindingen voor een snellere datatransmissie en de mogelijkheid om elektronica bij sensortoepassingen dichter bij de werkelijke meetplek te brengen, kunnen het beslissende voordeel bieden voor de volgende generatie producten.

Het KONEKT-project wordt gefinancierd door het EXIST-programma van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie en het Europees Sociaal Fonds.

Bezoek KONEKT op [www.micropack3d.com](http://www.micropack3d.com) of breng een bezoek aan de Embedded World Nürnberg 2020 (3A-522).



200006-03